

IC基板BGA芯片封装载板超薄4层线路板HL832NXA刚性薄型板打样批发

产品名称	IC基板BGA芯片封装载板超薄4层线路板HL832NXA刚性薄型板打样批发
公司名称	深圳嘉圳电子科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	嘉圳:IC载板 BGA:BGA 深圳:宝安
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新沙路星际大厦3A09
联系电话	18680337466 18680337466

产品详情

BGA一出现便成为CPU、南北桥等VLSI芯片的高密度、高性能、多功能及高I/O引脚封装的zuijia选择。其特点有:1.I/O引脚数虽然增多,但引脚间距远大于QFP,从而提高了组装成品率;2.虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,简称C4焊接,从而可以改善它的电热性能;3.厚度比QFP减少1/2以上,重量减轻3/4以上;4.寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;5.组装可用共面焊接,可靠性高;6. BGA封装仍与QFP、PGA一样,占用基板面积过大;Intel公司对这种集成度很高(单芯片里达300万只以上晶体管),功耗很大的CPU芯片,如Pentium、Pentium Pro、Pentium 采用陶瓷针栅阵列封装CPGA和陶瓷球栅阵列封装CBGA,并在外壳上安装微型排风扇散热,从而达到电路的稳定可靠工作。BGA球栅阵列封装随着集成电路技术的发展,对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所谓的“CrossTalk”现象,而且当IC的管脚数大于208 Pin时,传统的封装方式有其困难度。因此,除使用QFP封装方式外,现今大多数的高脚数芯片(如图形芯片与芯片组等)皆转而使用BGA(Ball Grid Array Package)封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的zuijia选择。